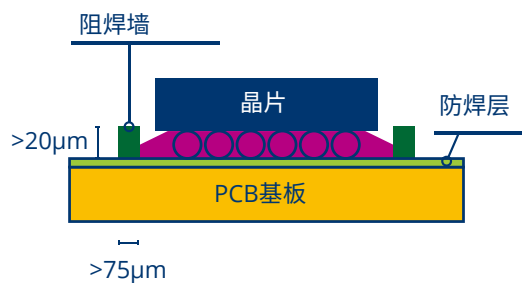


Orbotech Magna™

IC封装叠加喷印解决方案

更多的功能，更少的空间

微电子需求不断增长促使了对成本效益的追求和阻焊墙位置的精确定位，这些阻焊墙在特定功能的晶片周围形成屏障，以防止泄露。喷墨印刷提供了一种替代昂贵传统防焊影像转移或点胶机的方法，同时节省了封装的空间。



Orbotech Magna 创建阻焊墙

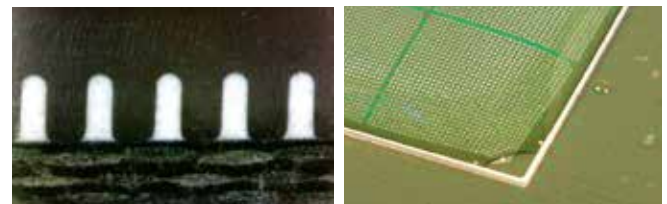
KLA的叠加喷印技术通过投放保护屏障来封闭晶片周围的区域，使制造商得以节省空间和生产成本。通过使用Orbotech Magna喷印解决方案建造阻焊墙，其结果会比传统工艺更精确、成本更低，Orbotech Magna 还节省了极其有限的封装空间，适用于倒装芯片规模封装 (FCCSP)、球栅阵列 (BGA) 和先进的封装芯片 (CIP) 模块。

- 先进的阻焊墙喷墨打印
- 支持高纵横比的阻焊墙的放置——最高可达0.5mm 高，75µm 宽
- 在不同的基材上提供优秀的附着力
- 支持strip, 大板, JEDEC 托盘, 晶圆
- 高产能，低整体拥有成本 (TCO)
- 高精度放置可以减少阻焊墙隔离区 (KOZ)



Orbotech Magna - 绝缘层直接喷印

- 无原料浪费
- 去除昂贵的光刻步骤-简化制程
- 无需光罩
- 总成本节约 40%
- 缩短新产品上市时间
- 适用于方形扁平无引脚封装 (QFN) 及芯片级封装(CSP)



传统工艺耗时长，成本高



Orbotech Magna - 快速，成本效益，环保



规格

| | |
|-----------------|--|
| 最大喷印面积 | 12" x 16" (304.8mm x 406.4mm) |
| 最小/最大板材厚度 | 4-256mil (0.1mm - 6.5mm) |
| 最小/最大分辨率 | 600 - 2400 dpi |
| 最小线宽 | 2.9mil (75µm) |
| 对位精确度 (FTG) | ±1.4mil (±35µm) |
| 最大距离 喷头/基材 | Up to 60mil (1.5 mm) |
| 对位 | 用户可选择对位点; 分割涨缩 |
| 条状/板材固定 | 标准: 条状板材 真空/夹具 选配: 客制化载具、JEDEC 托盘、大板 |
| 软件 | 软件RIP, CAM软件整合, Gerber RS-274X输入, 一按即印, 支持多种语言 |
| 油墨类型 | 由业界领先供应商提供的多款油墨 |
| 尺寸 (宽 x 深 x 高)* | 39.4" X 45.3" X 88.2" (1000mm x 1150mm x 2240mm) |
| 重量 | 1984lbs (900kg) |
| 自动化 | 配备第三方自动化设备整合界面 |

* 高度包含了系统运行状态警示灯塔高度

KLA 支持

保持系统生产力是 KLA 良率优化解决方案不可或缺的一部分。包括系统维护、全球供应链管理、降低成本和减少报废、系统迁移、性能和生产率提升以及转转售认证设备。

KLA Corporation
www.orbotech.com/pcb | www.kla.com
 Rev 3.0_6-13-2022